

# 中国国际半导体技术暨应用展-2024全新半导体材料展会学术会议

产品名称	中国国际半导体技术暨应用展-2024全新半导体材料展会学术会议
公司名称	中国（耀瀚）展会信息
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

## 产品详情

2024深圳国际半导体技术展览会展览时间：2024年6月26-28日展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

组织机构：中国通信工业协会、深圳市半导体行业协会、广东省集成电路行业协会、广州市半导体行业协会、江苏省半导体行业协会、浙江省半导体行业协会、成都市集成电路行业协会

### 展会介绍

中国半导体产业将顺势而为，逆势崛起

随着人工智能、智能汽车、无人机、汽车电子、安防、物联网、手机、消费及穿戴电子、家电、电源、5G通信等新技术的快速发展，推动了对于半导体需求的持续快速增长，为全球半导体行业增添了新的动力。

作为全球电子制造业的中心以及全球大的消费电子市场，近年来中国半导体产业也是增长迅速，中国已经成为全球大和贸易活跃的半导体市场。再加上中国政府对于半导体行业的大力扶持，中国半导体行业发展呈加速态势。

“十四五”期间，我国半导体产业将有更全面的发展，并将加快高端芯片设计等领域关键核心技术的突破和应用。随着中国对5G、AI、IoT和云计算、大数据等技术的大量投资，以5G网络、工业互/物联网等为代表的“新基建”将带动半导体产业的高速增长。据预测，到2030年我国的半导体市场供应将达到5385亿美元，依然为全球大，69%的消费量将来自中国本土公司，需求主要来自数据中心、消费电子、汽车、医疗等应用领域。

2024深圳国际半导体技术展览会展出面积5.5万平方米，将汇聚800多家展商集中展示集成电路、电子元器件

件、第三代半导体及产业链材料和设备为一体的半导体产业链。同期举办多场高峰论坛，参观观众达8万人次覆盖集成电路、5G应用、汽车电子、工业电子、医疗电子、物联网、消费电子、智能家电、新型显示、工业互联网、智能制造、人工智能、无线充电等领域。

展示范围一、电子元器件展区：无源器件、半导体分立器件/IGBT 5G核心元器件特种电子、元器件、电源管理、传感器、存储器、连接器继电器、线缆、接插器件、晶振、电阻、电位器磁性元件、滤波元件、PCB板、电机风扇电声器件、显示器件、二\*\*管、三\*\*管滤波元件、开关及元器件材料及设备等二、IC设计、芯片展区：IC及相关电子产品设计、人工智能芯片、电源管理芯片、物联网芯片、5G通信芯片及方案、汽车电子芯片、安全控制芯片、数模混合通讯射频芯片、存储芯片、LED照明及显示驱动类芯片等三、半导体设备展区：减薄机、单晶炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备、固晶机、等离子清洗设备、切割机、装片机、键合机、焊线机、回流焊、波峰焊、测试机、分选机、耦合机、载带成型机、检测设备、恒温恒湿试验箱、传感器、封装模具、测试治具、精密滑台、步进电机、阀门、探针台、洁净室设备、水处理等四、第三代半导体专区：第三代半导体碳化硅SiC、氮化镓GaN、晶圆、衬底、封装、测试、光电子器件（发光二\*\*管LED、激光器LD、探测器紫外）、电力电子器件（二\*\*管、MOSFET、JFET、BJT、IGBT、GTO、ETO、SBD、HEMT等）、微波射频器件（HEMT、MMIC）

五、晶圆制造及封装展区：晶圆制造、SiP先进封装、OSATs、EMS、OEMs、IDM、硅晶圆及IC封装基板、印制电路板、封装基板及设备组装和测试等、封装设计、测试、设备与应用制造与封测、EDA、MCU、印制电路板、封装基板半导体材料与设备六、半导体材料展区：硅晶圆、硅晶片、光刻胶、晶圆胶带、光掩膜版、电子气体、CMP抛光材料、光阻材料、湿电子化学品、溅射靶材、封测材料、切片、磨片、抛光片、薄膜等

#### 参展费用（Booth Rate）

标准展位：3m×3m=9m<sup>2</sup>；注：双开口加收10%双开口费，标准展位包括地毯、三面围板、公司名称楣板、咨询桌一张、折椅两把、射灯两盏、电源插座一个

豪华展位：3m×3m=9m<sup>2</sup>；注：双开口加收10%双开口费，标准展位包括地毯、三面围板、公司名称楣板、咨询桌一张、折椅两把、射灯两盏、电源插座一个

空地费用：（36m<sup>2</sup>起租）